



## 聯發科技採用台積公司3奈米製程生產的晶片已成功完成設計定案

### 預計於2024年量產

發佈單位：聯發科技、台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2023年9月7日

聯發科技與台積公司今（7）日共同宣佈，聯發科技首款採用台積公司3奈米製程生產的產品天璣旗艦晶片開發進度十分順利，日前已成功完成設計定案（tape out）並預計明年量產。聯發科技與台積公司長期保持緊密且深度的戰略合作關係，雙方充分發揮各自在晶片設計和製造方面的獨特優勢，共同打造擁有高性能、低功耗特性的高能效旗艦晶片，賦能全球終端裝置與設備。

聯發科技總經理陳冠州表示：「聯發科技在拓展全球旗艦市場的策略上，致力用全球最先進的技術為使用者打造尖端科技產品，提升及豐富大眾生活。台積電穩定且高品質的製造能力，讓聯發科技在旗艦晶片的優異設計得以充分展現，提供全球客戶高性能、高能效且品質穩定的最佳方案，並持續提升旗艦市場的使用者體驗。」

台積公司歐亞業務及技術研究資深副總經理侯永清博士表示：「多年來，台積公司與聯發科技緊密合作，為市場帶來了許多重大的創新，我們也很榮幸能繼續在3奈米及更先進的技術上攜手合作。台積公司與聯發科技在天璣旗艦晶片上的合作，將半導體產業最頂尖的製程科技帶入智慧手機等行動裝置，讓全球使用者零距離享受無與倫比的體驗。」

台積公司3奈米製程技術不僅為高效能運算及行動應用提供完整平台支持，還擁有更強化的效能、功耗及良率。相較於5奈米製程技術，台積公司3奈米製程技術的邏輯密度增加約60%，在相同功耗下速度提升18%，或在相同速度下功耗降低32%。

聯發科技一直以業界領先的製程技術打造旗艦 Dimensity 天璣產品，滿足使用者在行動運算、高速連網、人工智慧、多媒體娛樂等領域不斷升級的體驗需求，賦能手機、平板電腦、智慧汽車等各類裝置與設備。聯發科技首款採用台積公司3奈米製程的天璣旗艦晶片將於2024年下半年上市，為新世代終端裝置注入強大實力，帶動使用者體驗邁向新篇章。



## 關於聯發科技

聯發科技股份有限公司（TWSE：2454）是一家全球無晶圓廠半導體公司，在智慧手持裝置、智慧家庭應用、無線連結技術及物聯網產品等市場位居領先地位，每年約有 20 億台內建聯發科技晶片的終端產品在全球上市。聯發科技力求技術創新，為智慧型手機、平板電腦、智慧電視與機上盒、穿戴式裝置與車用電子等產品，提供具備高效能、低功耗的行動運算技術與先進的多媒體功能。聯發科技致力讓科技產品更普及，因為我們相信科技能夠改善人類的生活、與世界連結，每個人都有潛力利用科技創造無限可能。更多訊息請參考官網：[www.mediatek.tw](http://www.mediatek.tw)

## 關於台積公司

台積公司成立於1987年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2022年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等288種製程技術，為532個客戶生產1萬2,698種不同產品。台積公司企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站<https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

# # #

### 台積公司發言人：

黃仁昭  
副總經理暨財務長  
Tel: 03-505-5901

### 台積公司新聞連絡人：

高孟華  
企業公共關係部主管  
Tel: 03-563-6688 ext. 7125036  
Mobile: 0988-239-163  
E-Mail: [nina\\_kao@tsmc.com](mailto:nina_kao@tsmc.com)

孔培德  
企業公共關係部  
Tel: 03-563-6688 ext. 7125031  
Mobile: 0988-931-352  
E-Mail: [pdkramer@tsmc.com](mailto:pdkramer@tsmc.com)

### 聯發科技媒體聯絡人：

吳英英 Sabrina Wu  
Tel: +886-3-5670766 Ext.30156  
Mobile: +886-900737190  
[sabrina.wu@mediatek.com](mailto:sabrina.wu@mediatek.com)